

证券代码： 600601

证券简称： 方正科技

方正科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号： 2024-0501

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024 年 5 月 6 日-5 月 22 日
地点（方式）	线上、线下交流
参与单位（或人员）	广发证券、华商基金、中欧基金、泰康资产、华西证券、兴业证券、路博迈、长信基金、易方达基金、华泰资产、海富通基金、东方财富证券、太平养老保险、民生证券、财通证券
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：梁加庆 证券事务代表：戴继东
投资者关系活动主要内容介绍	<p>调研会议互动问答的主要内容如下：</p> <p>问：公司 2023 年的经营状况？</p> <p>答：在 PCB 市场下行、需求疲软的不利行业环境下，公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的市场发展理念，主攻国内大客户市场，积极开拓国外等新兴市场。推进精细化管理，全面降本增效，保障了公司经营健康稳健运行。公司实现营业收入 31.49 亿元，</p>

同比下降 35.59%，系 2022 年末剥离方正宽带及方正国际业务所致；归属于公司股东的净利润 1.35 亿元，上年同期数为-4.24 亿元，同比扭亏为盈。其中，公司 PCB 业务实现营业收入 30.22 亿元，实现净利润 1.78 亿元。

同时公司通过强化内部管控，优化授权决策机制，公司的规范运作水平得到持续提升，成功撤销了退市风险警示及其他风险警示，公司重归良性发展轨道。

问：公司 2024 年一季度经营情况？

答：2024 年第一季度，公司实现营业收入 7.69 亿元，同比增长 13%；归属于公司股东的净利润 7,690.94 万元，同比扭亏为盈。主要系公司优化 PCB 业务产品结构，高毛利产品增加以及公司处置了不动产房屋。

问：公司 2024 年一季度报告中的资产处置收益情况如何？有持续性吗？

答：公司基于支持主营业务运营与发展的考虑，积极盘活低效资产，将位于深圳市福田区的不动产房屋通过网络平台进行拍卖并成功交易，实现净收益 2,974.52 万元。针对历史遗留的其他低效资产，公司也正在积极探索盘活方案。

问：公司产能扩产投资情况？

答：公司现有在运营的工厂共 4 间，公司持续对现有工厂进行技改，提升技术水平。目前 F3 工厂的技改和 MSAP 产线的投资已完成，高端 HDI 产能稳步提升。投资 6.896 亿元建设的 F7 二期高阶 HDI 项目，将于 2024 年 5 月底完工；投资约 9.43 亿元在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，目前正在按计划推进。

问：公司项目资金来源是什么？有否有资本市场融资计划？

答：目前公司投资的资金来源主要为自有资金和金融机构借款。公司将根据公司战略发展规划、外部经营环境、实际投资需求以及相关政策的变化制定公司中长期投融资规划。

问：未来公司是否会进入其他领域？比如是否会进入封装基板行业？

答：目前公司提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案。公司也将积极寻求产业链上下游的并购机会。

问：公司在境外的业务布局？

答：境外业务主要是公司 PCB 产品的出口，地区包括北美、欧洲、日本、韩国及其他亚洲国家或地区，境外业务约占公司整体营收的三分之一。

公司正在积极开拓境外市场，有序推进投资建设方正科技（泰国）智造基地项目，以满足境外订单需求。

问：公司 PCB 产品是否能应用在服务存储和光模块领域？

答：公司的 PCB 产品在服务存储和光模块领域均有应用。服务存储方面，主要包括服务器、数据存储、加速卡、显卡、SSD 等领域，公司已具备 AI 服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶 HDI 的制作能力。光模块方面，主要包括光通讯模块和连接器等领域，公司已批量生产 10G-100G-200G-400G-800G 等光模块产品，同时，1.6T 连接器和光模块产品分别已完成打样并具备批量生产能力。公司 PCB 下游终端产品广泛应用于数据中心、计算中心和电信运营商用户等。

问：公司目前的技术布局？

答：公司在高多层板及 HDI 技术领域有丰富的技术沉淀，生产技术达到国内先进水平。公司与国内通讯行业领军企业建立长期深度合作，同步展开多个 5G 主板及天线板 PCB 的研发项目；成功开发

出 FVS, 将 PCB 损耗控制和布线密度提升到更高的水平; 开发出 Z-向互联技术, 实现了多 PCB 的堆叠互联, 有助于超高厚径比和局部高密复杂设计的产品的制作; 其他特色工艺如 Cavity、UHD、阶梯金手指、特殊散热、能源厚铜和高端光模块等皆已量产, 助力客户在研发 N+1 和 N+2 代产品中带来设计、成本和制作周期的优势, 不断追求卓越水平。

问: AI 领域的发展对公司 PCB 业务影响情况如何?

答: AI 领域的发展, 对于高算力和高速网络的需求日益紧迫, 驱动了终端电子设备对高频高速、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升, 公司在 AI 相关领域的 PCB 业务也将受益。

问: 目前公司工厂整体稼动率如何?

答: 近期公司 PCB 工厂的稼动率较去年同期有所提升。

问: 公司其他非 PCB 业务如何处理, 后续是否考虑并购?

答: 公司目前还有少量的历史遗留业务——融合通信, 正在积极探索盘活方式, 未来公司将进一步聚焦 PCB 主业, 并结合经营战略需要, 寻找与公司 PCB 业务在市场、品类、技术等能够资源互补的标的, 探求战略并购。

问: 公司未来的战略规划?

答: 公司重整之后将专注于印刷电路板主业, 以中高端 HDI 板、高多层板为核心产品, 深挖客户需求, 加速推进产品结构升级, 在持续巩固通信设备、消费电子等传统市场优势的同时, 加速拓展新兴市场, 持续专注技术与品质的双轮驱动, 全面提升产品技术、质量及运营能力, 保持核心业务稳定增长, 高质量发展, 成为行业一流企业。

	<p>问：公司是否有股权激励方面的安排？</p> <p>答：公司将按照相关规定并结合公司实际经营情况予以综合考量。</p> <p>问：铜材料成本上升对公司是否有影响？</p> <p>答：公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐等，原物料供应的稳定性和价格走势影响公司生产的稳定性和盈利能力。近期受铜等大宗商品价格变化影响，部分材料价格有所上升，目前对公司经营影响可控。PCB 产品价格传导受产品结构和供需结构的影响，公司会积极与供应链和客户保持沟通，保证公司的良性经营。</p>
附件（如有）	无
记录时间	2024 年 5 月 23 日整理